

HB

中华人民共和国航空航天工业部 航空工业标准

HB 6187—89

航空用印制板元器件的安装焊接

1989—05—13 发布

1989—12—01 实施

中华人民共和国航空航天工业部

批准

目 录

1. 主题内容与适用范围.....	(1)
2. 引用标准.....	(1)
3. 装焊前的要求.....	(1)
4. 元器件、零件和导线的安装.....	(8)
5. 焊接要求.....	(19)
6. 灌封和粘接.....	(22)
7. 涂覆.....	(22)

1 主要内容与适用范围

本标准规定了元器件在印制板上安装焊接(以下简称装焊)的技术要求。
本标准适用于航空产品。

2 引用标准

GB3131	铅锡焊料
GB3375	焊接名词术语
GB5489	印制板制图
GJB457	机载电子设备通用规范
HB5832	航空用半导体二、三极管筛选技术条件
HB5833	航空用线性电路筛选技术条件
HB5834	航空用 TTL 集成电路筛选技术条件
HB6098	航空用印制电路术语和定义
HB6099	航空用印制电路板技术条件
HB6207	航空用印制线路设计

3 装焊前的要求

3.1 印制板、元器件、导线、零件和材料

待装焊的印制板、元器件、导线、零件和材料应符合 GJB457(机载电子设备通用规范)的规定。

3.1.1 印制板

待装焊的印制板应符合 HB6099 和 HB6207(航空用印制线路设计)的规定。

3.1.2 元器件

3.1.2.1 元器件筛选

待装焊的元器件必须 100%地按 HB5832、HB5833、HB5834 和有关标准规定筛选

3.1.2.2 MOS 器件

装焊 MOS 器件必须采取下列措施:

- 待装焊的 MOS 器件应存放在原包装内或金属盒里;
- MOS 器件的测试仪器、装配工具、设备和工作台面等均应与接地干线可靠共地;
- 接触 MOS 器件的人员必须穿棉布工作服,戴棉布工作帽,穿导电鞋和戴人体接地环。